

L40信息披露

2025年4月21日 星期一
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-020

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席胡国庆主持,应参加本次监事会会议的监事3名,实际参加本次监事会会议的监事3名。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司按照要求编制了2024年年度报告及其摘要,确认报告内容符合国家法律法规和会计准则的要求,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年年度报告》和《晶合集成2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为:根据2024年度公司运营情况,公司编制了《2024年度财务决算报告》,2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2024年度财务状况和经营成果等事项。公司2024年度财务报告已经经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

监事会认为:公司《2025年度财务预算》综合考虑了宏观经济政策执行情况和行业经济复苏状态,同意公司申报预测2025年度财务预算目标。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司于2024年度持续健全完善了内部控制管理体系,在所有重大方面保持了有效的内部控制,能够确保内部控制的基本准则得到有效执行,保证公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》反映了内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况,严格履行了分红决策程序,该实施方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。综上,监事会同意公司本次利润分配方案。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-017)。

(六)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

(七)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易及2024年度关联交易予以确认的议案》
监事会认为:公司2024年度日常关联交易符合公司业务发展和经营情况,履行了相关审议程序,公司预计的2025年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营管理需要的合理预计,交易具有必要性。关联交易定价以同类交易市场价格为依据,遵循公平、公正、合理的原则,交易执行按照公司日常关联交易管理制度进行管控,不存在损害公司利益及股东利益的情况。

关联监事胡国庆女士回避表决。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

(八)审议通过《关于2024年度董事工作报告的议案》
监事会认为:报告期内,监事会严格按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》等规定,勤勉尽责,依法独立行使职权。公司监事会从维护公司和股东权益出发,认真履行监督职责,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

2025年4月21日

公司代码:688249 公司简称:晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、经会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上年度末盈利且尚未实现盈利
☐ 是 ☒ 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分派现金股利,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

截至本报告披露日,公司总股本2,006,135,157股,扣除回购专用证券账户中股份数62,088,500股,以此计算实际可派发现金红利194,044,665.70元(含税)。本年度以现金方式分配、采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为891,677,308.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购合计1,086,081,974.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为203.83%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的股份数量为0元,现金分红和回购并注销金额合计194,044,665.70元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.48%。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户中股份余额)发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

8、公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况
☒ 适用 ☐ 不适用

股票种类 股票上市交易所简称 股票简称 股票代码 变更前股票简称
人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创板 晶合集成 688249 不适用

1.2 公司存续状况
☒ 适用 ☐ 不适用

1.3 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱才伟 曹霞

联系地址 安徽省合肥市蜀山区合肥综合保税区内内西内路88号 安徽省合肥市蜀山区合肥综合保税区内内西内路88号

电话 0551-62673000/051612688 0551-62673000/051612688

传真 0551-62673000 0551-62673000

电子邮箱 stock@hichip.com.cn stock@hichip.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况
公司以主要尺寸12英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力研发并应用行业先进的工艺,为公司提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务,并提供光刻镀膜制程配套服务。

在晶圆代工制程节点方面,报告期内工艺平台晶圆代工已实现150nm至55nm制程平台的全覆盖。55nm OLED显示驱动芯片批量量产,28nm逻辑芯片通过功能性验证并成功点亮电视面板,28nm制程平台其他产品的研发正稳步推进中;在工艺平台应用方面,公司已具备显示驱动芯片(DRDC)、CMOS图像传感器芯片(CIS)、电源管理芯片(PMIC)、微控制器芯片(MCU)、逻辑芯片(LoT)等工艺平台晶圆代工的技术能力。公司产品主要应用于智能手机、平板显示、安防、汽车电子、家用电器、工业控制、物联网等领域。

2.2 主要经营模式

1. 研发模式
公司制定了研发管理制度,明确了研发过程中各部门的权责关系与作业流程,确保研发过程符合公司战略发展方向,实现经济效益最大化。公司研发流程包括市场调研、策略制定、可行性评估、项目审批、技术研发、流片、工艺制程验证等环节。为保证研发效率及成本控制,公司还制定了严格的研究进度管理制度。

2. 采购模式
为加强成本控制,保证供应链服务品质,提高生产效率和存货周转效率,公司建立了严格的采购流程,完善的供应商准入机制和严格的供应商考核评价体系,以保证原材料、设备零件及设备质量的稳定性和供应的持续性。

公司的供应商主要包括原材料供应商和设备供应商,公司通常采用直接采购模式,如果终端供应商采取经销模式进行销售,则公司也可通过经销商向终端供应商进行采购。供应商经过资质评估、采购资格准入、工厂环评等环节评估通过后,方可成为公司的合格供应商,公司主要向进入公司合格供应商的供应商进行采购。后续再由相关部门对采购产品的质量、价格、服务等进行考核评价,以实现采购流程的闭环管理。

3. 生产模式
公司接到客户需求后,首先进行小批量试产;在良品率工艺条件稳定后,进入大量量产阶段;在各项交付指标达标后,与客户签订正式的销售合同或接受批量订单,按照客户需求分配产能,制定生产交付计划,进行大量生产。

4. 销售模式
公司建立了规范、完整的销售团队,拥有多元化的营销渠道,通过不同的营销方式拓展客户。公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度,对销售流程进行规范。

2.3 行业特点

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术“门槛”
公司主要从事12英寸晶圆代工业务及其配套服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据国家统计局战略性新兴产业分类(2019)(国家统计局令第23号),公司所处行业为战略性新兴产业中的“新型电子元器件

及设备制造”(分类代码:1.2.1)、“集成电路制造”(分类代码:1.2.4)。

半导体行业作为信息技术产业的核心,具有显著的战略性和先导性。半导体产品主要分为分立器件和集成电路,其中集成电路(Integrated Circuit, IC)是一种具备完整、复杂电路功能的微型电子器件,该器件通过专门的集成电路制造工艺,实现晶体管、电阻、电容、电感等元件及金属布线,并封装集成在一块或若干块半导体晶片上。集成电路被广泛应用于计算机、通信、消费电子(手机、电视、电脑等)、医疗、工业自动化、军事等领域,在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用,是现代社会不可或缺的基础。

集成电路行业呈现垂直化分工格局,上游包括集成电路材料、集成电路设备等;中游为集成电路生产,集成电路生产环节亦呈现垂直化分工格局,可以具体划分为集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装;集成电路产业下游为各类终端应用。

近年随着全球化信息潮流的不断推进,集成电路的应用领域实现了高速增长,逐渐成为全球经济的核心支柱产业之一,全球集成电路市场规模伴随着终端产品的发展而增长。2024年生成式人工智能(AI)全面爆发,推动半导体市场增长。在人工智能时代,集成电路应用存在巨大的创新空间,包括传感、存储、通信、安全和能源等众多方面。2024年端侧AI技术在手机、PC、可穿戴设备和物联网(IoT)等终端场景中加速落地,未来消费电子终端产品在软件、硬件、产品形态与版本方面将持续迭代,新技术和新应用将会带来重新购置升级换代设备的需求,除AI外,新能源汽车、智能制造、物联网等新兴产业,都是半导体产业蓬勃发展的助推器。

目前,中国是全球主要的电子信息制造业生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。据我国海关统计,2024年我国集成电路产量4,514亿元,同比增长22.2%;出口金额2,081.1亿元,同比增长11.6%;出口金额达1.14万亿元,同比增长18.7%。总体来看,2024年我国电子信息制造业保持稳健的增长态势,特别是在集成电路领域表现突出,出口市场有所回暖。未来随着集成电路产业国产替代进程的加快推进,以及在人工智能、5G、云计算、智能制造等领域的广泛应用需求的驱动下,中国集成电路行业将获得更多的发展机遇。

公司处于集成电路晶圆代工行业,集成电路工业不包含集成电路设计环节,专门负责晶圆制造,为集成电路设计公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业,需要大量的资本和人才投入。芯片制造工艺高度复杂,所需原材料和设备种类繁多,制造周期长,需要全球产业链的支持,需要深厚的专业知识和工程人才,并能够持续技术创新和工艺技术积累,具有较高的进入壁垒。

(2)、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司立足于晶圆代工领域,依靠成熟制程的制造经验,以面板显示驱动芯片为基础,获得了良好的行业认知度,客户群体覆盖多个国际一线公司;同时,在图像传感器芯片、电源管理芯片、微控制器芯片等领域,公司也已与国内外行业领先芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。目前公司在液晶面板显示驱动芯片代工领域市场占有率处于领先地位。根据TrendForce集邦咨询公布的2024年第四季度全球晶圆代工行业营收排名,晶合集成位居全球第九位,在中国大陆企业中排名第三。

(3)、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①OLED面板产业带来新的机遇
OLED面板是利用有机电自发光二极管制成的显示屏,具备无需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、易于制作柔性面板等特性,拥有画质优良、健康护眼、节能省电等优势。柔性OLED面板凭借鲜艳的色彩、超薄的设计和更广泛的视角,正在迅速赢得用户的青睐。随着5G技术的广泛应用和更多高性能应用程序的出现,对高画质显示需求的需求将持续增长。根据智研咨询(Sigament)的数据显示,2024年OLED全球智能手机品牌需求约8.2亿片,渗透率达到55.9%,其中柔性OLED面板需求约6.2亿片,占总渗透率的42%,2025年OLED在全球智能手机品牌需求将达到8.6亿片,渗透率将提升至57.5%,其中品牌对柔性OLED需求约6.7亿片,占比将达到44.9%。OLED驱动芯片是OLED面板的核心部件,随着OLED面板需求增长,OLED显示驱动芯片出货量有望持续提升。

公司在OLED显示驱动芯片代工领域积极布局,未来将具备成熟的OLED驱动芯片工艺平台。目前公司40nm高压OLED显示驱动芯片已实现量产,28nm OLED显示驱动芯片研发进展顺利。

②CIS国产产业链加快

近年来,全球CIS销售额总体呈现稳定增长态势。据Yole-数据预测,预计到2028年全球CIS市场规模将进一步增长至288亿美元,2022年至2028年复合增长率约为5.1%。长期以来,高性能CIS主要由索尼、三星供应,但目前国产CIS在手机市场主流SOMP产品方面已经形成突破。在国内国产替代的大浪潮下,本土头部CIS厂商具备了多方面优势,技术差距在缩小,而国内企业积极拥抱本土厂商的态度也较好,符合国家自主可控的科技进口替代、自主可控的大趋势。除了手机市场外,汽车市场也成为了CIS增长的新动力。随着智能网联汽车的快速发展,高级辅助驾驶系统的市场需求旺盛,推动了汽车摄像头模组和CIS的销量增长。据统计,未来单年摄像头出货量有望攀升,为CIS市场带来巨大的增长潜力。因此随着智能手机、安防、工业等领域需求以及不断扩大的应用市场和成熟、无人、AR/VR、机器视觉等新兴领域快速渗透,参加国产替代进程加快,CIS市场将持续增长。

2024年公司55nm中高端BSI和堆栈式CIS芯片工艺平台实现大批量生产,产品像率达到5000万,产品广泛用于智能手机主摄、辅摄及前置镜头等,公司产品顺利从中安防应用提升至中高端应用。

③汽车芯片市场快速增长
新能源汽车的半导体含量是传统内燃机汽车的两倍到三倍,各辅助驾驶和智能座舱功能的汽车芯片用量更高。当前随着全球化新能源汽车产业的发展,汽车“新四化”转变步伐日加快,汽车芯片成为提升智能驾驶性能的重要载体,迎来高速发展浪潮,国产市场替代国内成熟产业链和硬件的创新优势逐步实现弯道超车,进而带动本土汽车芯片供应链迎来市场导入的机会窗口。

公司积极服务汽车产业链的需求,布局车用芯片市场。在汽车芯片制程能力建设上,公司已取得国际汽车产业链管理体系统认证,并通过多个工艺平台的车规验证。目前55nm车载显示驱动芯片已量产。

④电源管理芯片需求增长
电源管理芯片是在电子设备系统中实现对电源的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片,电子产品和设备所需的电能供应中板和组串,是电子产品中不可或缺的关键部件。电源管理芯片直接影响电子设备性能,也是现代电子产品中必不可少的一类芯片,几乎所有电子和电子系统都使用电源管理芯片。由于应用场景广泛、下游应用领域发展迅速以及不断扩大的应用市场和成熟、无人、AR/VR、机器视觉等新兴领域快速渗透,参加国产替代进程加快,CIS市场将持续增长。

电源管理芯片已成为公司第三大产品品类,未来公司产品将应用于更多领域。

⑤AR/VR新兴应用领域的发展加速显示技术应用落地
VR、AR、MR等多种技术统称为XR(Extended Reality),中文名为扩展现实,是指将现实与虚拟相结合进行人机互动的可穿戴设备,通过结合三者的视觉交互技术相融合,为体验者带来虚拟世界中现实世界之间无缝切换的“沉浸感”。目前主流的XR包括了VR虚拟现实,AR增强现实,MR混合现实等。XR具有更具沉浸式的、更直接交互的互动方式及更强计算能力等,被认为是下一代移动计算平台。作为将现实与虚拟场景连接的硬件设备,近年来VR/AR/MR相关产品备受关注。据IDC中国统计,2024年公司AR/VR市场预计出货量为53.5万台,同比下降26.3%。尽管面临宏观经济及消费购买力波动等不确定性因素,但产品技术革新、AR/VR以及新兴VR市场将推动市场回暖,2025年中国AR/VR市场出货量将增长114.7%,其中AR市场增长尤为显著。

Micro OLED又名硅基OLED,是应用于显示领域的OLED技术,在硅基板(CMOS驱动)的基底上制作OLED显示器件的新型平板显示技术,其将传统外延制备的显示芯片集成在硅基板中。相较于OLED,Micro OLED技术可以实现更高的像素密度和分辨率,响应速度更快,且不需要复杂的封装技术,成本更低。受益于XR行业需求,市场规模快速扩大。

公司针对AR/MR微显示技术,正在推进硅基OLED相关技术的开发,已与国内外领先企业开展深度合作。目前110nm AR/MR芯片已成功点亮面板,产品研发进展顺利。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.1.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	50,398,579,443.20	48,167,279,600.77	4.66	38,764,574,541.96
归属于上市公司股东的净资产	20,870,311,807.81	21,409,804,721.09	-2.52	13,124,156,903.71
营业收入	9,249,252,348.20	7,243,541,372.63	27.69	10,050,948,685.55
归属于上市公司股东的净利润	532,840,611.25	211,629,145.60	151.78	3,045,400,810.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,366,803.85	47,129,534.95	736.77	2,878,346,415.27
经营活动产生的现金流量净额	2,761,311,250.00	-161,053,964.83	不适用	6,280,053,397.39
加权平均净资产收益率(%)	2.52	1.09	增加1.43个百分点	26.91
基本每股收益(元/股)	0.27	0.12	125.00	2.02
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.12	125.00	2.02
研发投入占营业收入的比例(%)	13.88	14.60	减少0.72个百分点	8.53

3.2 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,227,893,274.41	2,169,883,982.29	2,377,274,489.11	2,474,206,022.39
归属于上市公司股东的净利润	79,258,819.88	107,743,718.00	91,932,173.17	253,905,900.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,309,730.50	37,365,152.44	84,700,556.85	214,991,364.06
经营活动产生的现金流量净额	394,884,867.30	900,280,528.06	671,436,552.42	794,529,303.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☐ 适用 ☒ 不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年12月31日
总资产	50,398,579,443.20	48,126,279,600.77	4.66%
归属于上市公司股东的净资产	20,870,311,007.81	21,409,804,721.09	-2.52%
营业收入	9,249,252,348.20	7,243,541,372.63	27.69%
归属于上市公司股东的净利润	532,860,611.25	211,629,145.60	151.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,366,803.85	47,129,534.95	736.77%
			2,878,346,415.27

上述股东关联关系或一致行动的说明 合肥晶源与合肥晶建设为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的说明 无

存托凭证持有人情况
☒ 适用 ☐ 不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
☒ 适用 ☐ 不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
☒ 适用 ☐ 不适用

